元器件生产厂商自查承诺书

依据ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》和ZKB 3101-002-2022《WQZB使用国产电子元器件“W、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展ZZKK等级和“W、空、包”情况自查及评估。结果如下:

自查产品共6项，其中ZZKKA级0项、B级6项、C级0项、C*级0项、D级0项、E级0项；W国产化0项、BZ国产化0项、KX国产化0项。

电子元器件“W、空、包”审查基本信息填写表详见附表1;

电子元器件使用IP核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表2。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。

无锡泰连芯科技有限公司（盖章）

2026年01月12日

附表 1 电子元器件“W、空、包”审查信息一览表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	生产厂商	ZZKK等级	是否“W 国产化”		是否“BZ 国产化”		是否“KX 国产化”		备注
								是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX421AYSF3	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX422AYSF3	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX421AYSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX422AYSF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	TLX421AYSF3	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	TLX422AYSF3	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填报单位（盖章）：　法定代表人（签字）：　填表人（签字）：侯仕颖电话：13699386074　填报日期：20260112

填表说明：

1.一级、二级、三级分类按ZKB3101-002附录A填写

2.元器件名称：应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

3.型号规格：应填写元器件完整型号规格；

4.生产厂商：应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；

5.Wkb：按照ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》执行，分为A、B、C、C*、D、E六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照GJB 9530执行；

6.“Wkb”应按照ZKB3101-002-2022标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；

7.若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。

附表 2 电子元器件基本信息表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	使用 IP 核情况				原材料和零部件				流片工艺”		备注
						名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否核心/关键	来源单位	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX421AYSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	2um Bipolar	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
2	半导体集成电路	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX422AYSF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	2um Bipolar	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
3	半导体集成电	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX421AYSF3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	2um Bipolar	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				
4	半导体集成电	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	JTLX422AYSF3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	2um Bipolar	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通通富				

5	半导体集成电	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	TLX421AYSF3	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	2um Bipolar	境内	
						IP核2	/	/	/	封装	/	南通通富				
6	半导体集成电	通用模拟电路	基准电路	并联电压基准源	TLX422AYSF3	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	2um Bipolar	境内	
						IP核2	/	/	/	封装	/	南通通富				

填报单位（盖章）：　　法定代表人（签章）：　　填表人（签字）：侯仕毅　电话：13699386074　填报日期：20260112

填表说明：

1. 一级、二级、三级分类按ZKB3101-002 附录A填写
2. 元器件名称：应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
3. 型号规格：应填写元器件完整型号规格；
4. 使用IP 核情况：仅适用于半导体集成电路，应填写IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
5. 原材料和零部件：本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含ZKB 3101-002-2022 标准附录A中零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
6. 是否“核心”/“关键”：应根据ZKB 3101-002-2022 标准附录A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；

7.来源单位：应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
8.流片工艺：仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如45nmBCD 工艺等；
9.若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。